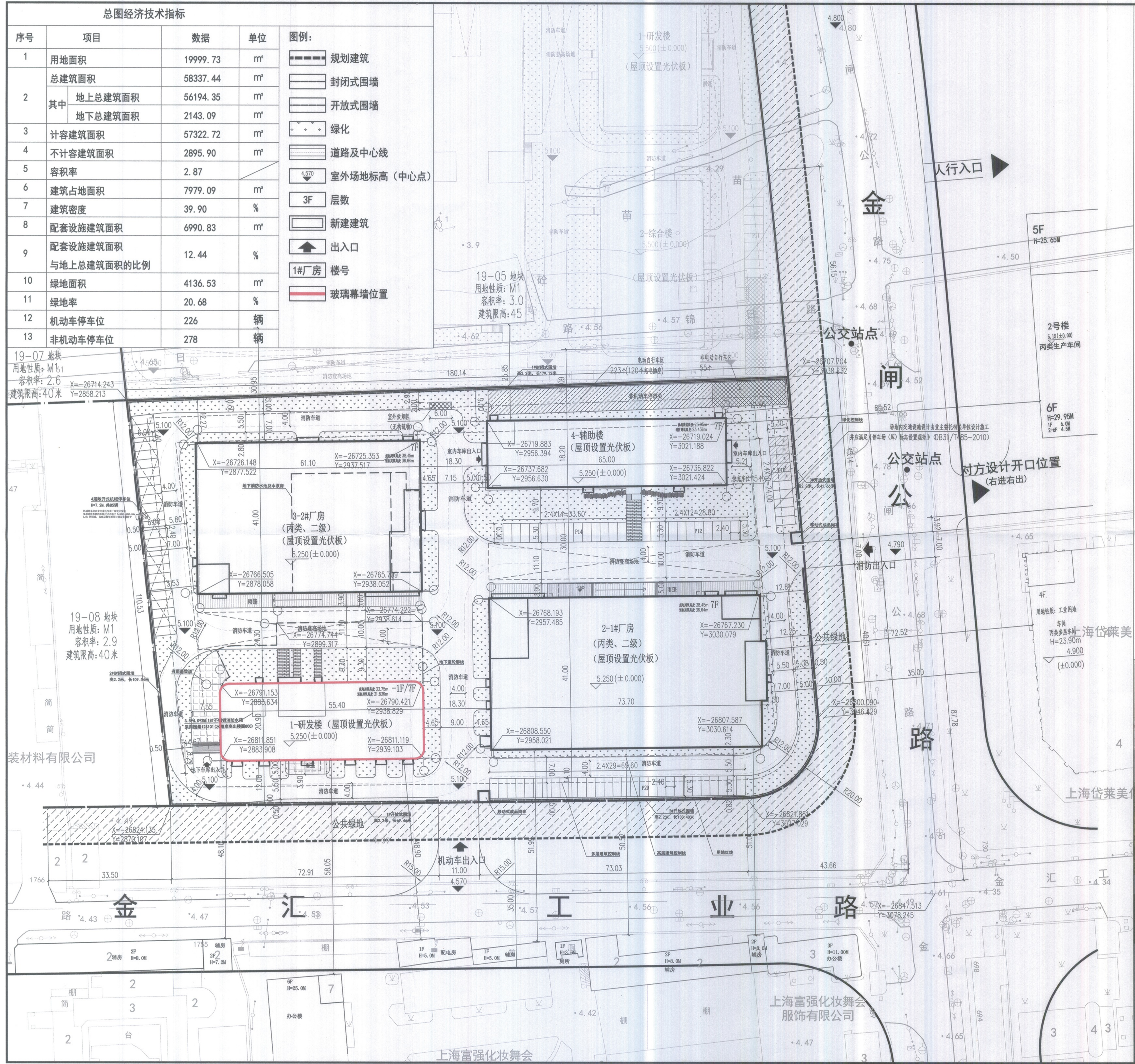




上海臻悦包装科技有限公司
臻悦智能化高端包装产业项目设计方案公示

项目概况:本项目建设用地位于上海市奉贤区金汇镇金汇工业区19-06号地块,项目基地东至金闸公路、南至金汇工业路、西至19-08规划用地、北至19-05规划用地,项目建设用地面积为19999.73平方米,用地性质为一类工业用地。

建设概况:本次方案公示单体分别为1栋研发楼、2栋厂房、1栋辅助楼等。最高单体高度38.45米。具体规划总平面图和经济技术指标如左图。

本项目局部采用玻璃幕墙系统,具体位置详见左图。现根据《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》《上海市建设工程设计方案规划公示规定》在基地现场和局网站进行公示,听取市民意见。如对本方案有异议请在公示之日起17日内与上海市奉贤区规划和自然资源局联系,公示期为10天。

特此公告。

公示期限:2025年09月23日至2025年10月02日

反馈意见截止期限:2025年10月09日

上海市奉贤区规划和自然资源局

2025年09月23日

反馈意见途径:

上海市奉贤区规划和自然资源局

地址:上海市奉贤区南桥镇南亭公路1号房地大厦

联系人:王老师

联系电话:021-57186309

建设单位:上海臻悦包装科技有限公司

地址:上海市闵行区景联路189号13栋2楼

联系人:张贤超

联系电话:13917133181

属地街镇:上海市奉贤区金汇镇人民政府

地址:上海市奉贤区金汇镇汇中路1666号

联系人:倪老师

联系电话:18717858218

